

TS-TIF®100C 5045-11系列是一种硅胶导热材料，专为填充发热器件与液冷板或金属底座之间的间隙设计。它的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。凭借卓越的热传导性能，其能够将热量快速从发热元件或PCB传递到液冷板或金属散热结构，从而提升高功率电子组件的散热效率，延长设备的使用寿命。

### 特性

- 》良好的热传导率
- 》带自粘而无需额外表面粘合剂
- 》高可压缩性,柔软兼有弹性
- 》可提供多种厚度选择
- 》良好的化学稳定性

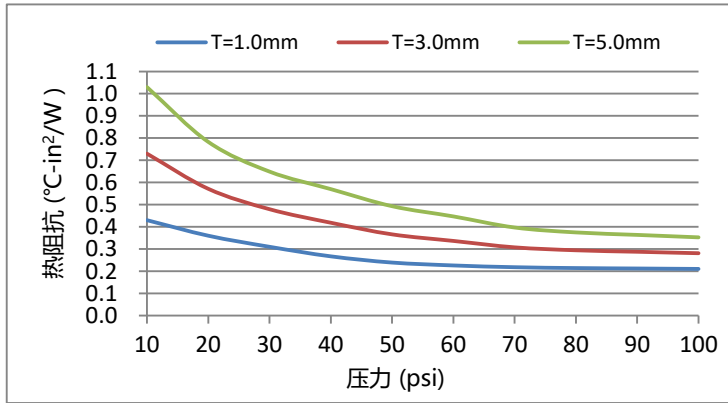
### 应用

- 》CPU、GPU处理器等芯片组
- 》高性能计算 (HPC)
- 》工业设备
- 》网路通讯设备
- 》新能源汽车

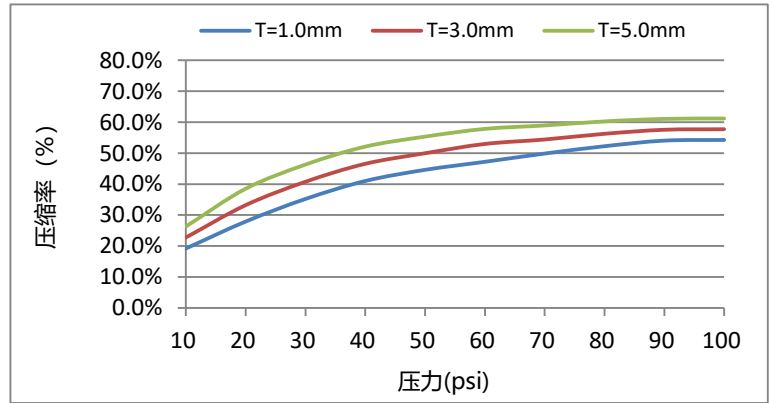
TS-TIF® 100C 5045-11 系列特性表

产品特性	典型值	测试方法
颜色	灰色	Visual
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	-
厚度范围	0.012"(0.30mm)~0.200" (5.00mm)	ASTM D374
硬度 (Shore OO)	45	ASTM D2240
密度 (g/cm <sup>3</sup> )	3.2	ASTM D792
建议使用温度范围 (°C)	-40~200	-
击穿电压 (T=1.0mm, Vac)	≥5500	ASTM D149
介电常数 @1MHz	6.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	≥1.0X10 <sup>12</sup>	ASTM D257
导热系数 (W/mK)	5.0	ASTM D5470
	5.0	ISO22007-2.2
阻燃等级	V-0	UL 94

### 热阻抗



### 压缩率



### 产品规格

标准厚度:0.012"(0.30mm)~0.200" (5.00mm)

标准尺寸:8"×16" (203mm×406mm)

TIF系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

安全处置方法无需特别防护，存储方法低温干燥，远离明火，避免阳光直射即可，详细方法可参考产品物质安全资料表。



导热材料

导热工程塑料

发热材料

屏蔽材料

发泡硅胶

模切制品

加拿大 Canada

TEL: +001-604-2998559  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.thermazig.com>

台湾 Taiwan

TEL: +886-2-22771007  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.ziitek.com.tw>

东莞 Dongguan

TEL: +86-769-38801208  
E-mail: frances@ziitek.com.tw  
<http://www.ziitek.com.cn>

昆山 Kunshan

TEL: +86-512-57816297  
E-mail: kelvin@ziitek.com  
<http://www.ziitek.com.cn>

长沙 Changsha

TEL: +86-731-86949836  
E-mail: jor@ziitek.com  
<http://www.ziitek.com.cn>